

500°C 초고온 자동 벤치탑 핫 프레스 5톤 180X180Mm 플래튼

품목 번호: XP66



소개

5톤의 압력, 180x180mm 플래튼, 통합 수냉 시스템을 갖춘 완전 자동 유압 제어 기능을 갖춘 500°C 초고온 자동 벤치탑 핫 프레스를 살펴보세요. 폴리머, 복합 재료, 배터리 및 첨단 소재 연구에 완벽하며, 정밀하고 일관된 열처리 결과를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
고성능 폴리머 성형	폴리이미드(PI), 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 및 기타 고온 열가소성 수지 및 불소 고분자의 가공. 이러한 소재는 성형, 경화 또는 필름 형성을 위해 최대 500°C의 지속적인 온도가 필요합니다.	균일한 소재 유동 및 결정화를 달성하여 내부 응력과 치수 부정확성을 최소화합니다.
첨단 세라믹 및 유리 소결	제어된 압력 하에서 유리 분말, 미결정 유리 및 전자 세라믹의 저온 접합, 예비 소결 및 열처리.	첨단 무기 소재 프로토타이핑을 위한 정밀한 치밀화 및 미세 구조 개발을 가능하게 합니다.
고체 배터리 인터페이스 공학	계면 저항을 줄이기 위해 고온과 균일한 압력이 필요한 전고체 배터리의 캐소드/고체 전해질/애노드 층의 열압축 접합.	셀의 이온 전도성과 기계적 무결성을 향상시켜 고체 배터리 R&D를 가속화합니다.
다층 복합 재료 라미네이션	항공우주 또는 전자용 첨단 프리프레그, 금속-폴리머 라미네이트 및 구조용 복합 재료의 고온 경화 및 접합.	우수한 기계적 및 열적 특성을 갖는 보이드가 없고 고도로 균일한 라미네이트를 생산합니다.
폴리머 필름 및 막 생산	정밀한 두께 및 다공성 제어가 필수적인 여과, 에너지 및 센서 응용 분야를 위한 고온 폴리머 필름의 캘린더링 및 압축.	확장 가능한 연구에 적합한 엄격한 공차와 일관된 품질을 갖는 필름을 생성합니다.
전자 패키징 및 언더필	반도체 및 PCB 조립을 위한 접착제, 봉지제 및 언더필 재료의 고온 경화.	보이드가 없는 접합과 일관된 열 사이클 저항성을 보장합니다.
섬유 강화 복합 재료 R&D	기계적 특성 평가를 위한 탄소 섬유, 유리 섬유 또는 아라미드 강화 열가소성 또는 열경화성 복합 재료 쿠폰의 제작.	제어된 압력과 열 하에서 적층 구성의 신속한 프로토타이핑 및 테스트를 가능하게 합니다.
일반 소재 연구 및 샘플 준비	기계적 테스트, 분광법 또는 현미경 관찰을 위한 샘플을 준비하는 학술 및 산업 연구소를 위한 다용도 플랫폼. 프로그래밍 가능한 사이클은 표준화된 준비를 보장합니다.	워크플로우를 간소화하고 재현성을 향상시켜 실험실 생산성을 높입니다.

매개변수	사양	비고
모델	XP66	이전 명칭: PCH-5T1818A / PCAH-5T1818A
작동	완전 자동 유압 제어	원버튼 금형 닫기, 가압 및 프로그래밍된 가열
최대 힘	0 - 5 톤 (0 - 50 kN)	정밀 조정 가능한 압력
작동 온도	0 - 500°C (최대 500°C)	고온 소재 R&D를 위한 초고온 구성
가열 전력	1500 W	부드러운 가열, 우수한 단열
플래튼 크기	180 × 180 mm	컴팩트 이중 영역 가열 플레이트
최대 표면 압력	~15.4 Bar (1.54 MPa)	정밀 라미네이션 및 폴리머 필름 경화에 적합

매개변수	사양	비고
냉각 방식	순환 수냉	작동 온도가 150°C를 초과할 때 수냉기 연결 필수
전원	AC 220V / 50Hz (단상)	작동 전류 약 6.8 A, 플러그 앤 플레이
설치 치수 (W×D×H)	290 × 290 × 420 mm	벤치탑 수직 컴팩트 구조
무게	90 kg	무게 중심 설계; 2인 운반 권장